

## 2-1-1-10 部分的P SR 現像残り／局部的 PSR 显影不净 / Partially underdeveloped photo solder resist

【特徴】 P SRパターンコーナや、スルーホールの一部にだけまともなPSRが残っている状態の欠陥

【特徴】 在PSR图形的拐角，或者通孔等的局部有PSR 残留的缺陷。

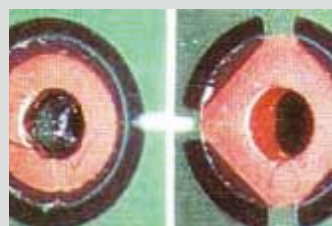
【Characteristics】 Photo solder resist is left locally in an area at the conductor edges or the inside of through holes

【原因・判断ポイント・発生工程】 P SR 現像液噴射ノズルの一部が詰まり、現像液が噴射されなかった為に、そのノズル位置に相当する部分に列状にP SRが残って出来たもの（P SR 現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】 PSR 显影液喷嘴的局部堵塞，不能喷射显影液，在该喷嘴相同位置有列状的PSR 残留（PSR 显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A part of the spray nozzle is clogged so that the photo solder resist facing the clogged holes is left undeveloped in a line because developer does not develop the resist there. (Photo solder resist development process)



【コメント】  
左不良、右良品  
顕微鏡倍率×20

【注釋】  
左为不合格品，右为合格品  
显微镜倍率 ×20

【Comments】  
Left: Rejected Right: Good  
Magnification: ×20



【コメント】  
顕微鏡倍率×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

## 2-1-1-11 非スル穴 SR 垂込み／SR 进入非通孔 / Solder resist dripped in non-plated through hole

【特徴】 S Rが非スル穴に単独または複数垂れ込んでいる状態の欠陥

【特徴】 SR 单独或者多点进入非通孔的缺陷。

【Characteristics】 Solder resist dripps in a non-plated through hole in one or more streaks

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R インクの粘度が低過ぎた上、S R 逃げ量の少ない製品の印刷版合わせズレが重なってできたもの（S R 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 SR 油墨的粘度太低，加上SR 图形挡油环小，网版偏移所造成的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Use of solder resist ink of too low viscosity and misalignment of printing screen for a product having a small hole-to-resist pattern clearance causes the defect. (Solder resist application process)



【コメント】  
顕微鏡倍率×55

【注釋】  
显微镜倍率 ×55

【Comments】  
Magnification: ×55



【コメント】  
顕微鏡倍率×25

【注釋】  
显微镜倍率 ×25

【Comments】  
Magnification: ×25